財務概況

▼ 損益状況

当期の事業環境

2020年3月期における世界経済は、中国などアジア地域で一部弱さが見られ、英国のEU離脱による不安などから、その伸びは鈍化傾向にあったものの、米国経済は底堅く、また欧州は回復基調を維持し、総じて緩やかな拡大が続きました。

半導体製造装置向け投資調整の大きな要因であった半導体メモリの需給も、緩やかに改善に向かいました。メモリ向け投資は調整されましたが、メモリ価格は下げ止まり、当期末にかけて投資は回復基調に転じました。一方、2020年以降に本格化するデータ社会の実現に向けて、PCやデータセンター向け高性能マイクロプロセッサ、5G対応スマートフォン向け次世代アプリケーションプロセッサの需要は増加し、ロジック/ファウンドリ向け投資は大きく成長しました。また、パワーデバイスやディスクリートなど、技術的に成熟した世代の半導体の需要も増加し、メモリ向け投資が抑制される中でも、半導体前工程製造装置市場は3年連続で500億米ドルを超える高水準が維持されました。

ディスプレイ市場においては、モバイル端末の出荷台数の鈍化により有機ELディスプレイを目的とした中小型パネル向けの投資に調整が見られたものの、液晶テレビを目的とした第10.5世代の超大型パネル向けの投資は前期に引き続き高水準で推移しました。フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置市場は、前年比約25%程度の減少となりましたが、半導体同様、ディスプレイにおいても、年後半から需要が回復傾向に転じました。2020年は、モバイル向け有機ELディスプレイの需要がけん引役となり、FPD製造装置市場の成長が期待されます。

売上の状況

2020年の年初から新型コロナウイルス感染症が広がり、当社業績への影響が懸念されましたが、半導体およびFPDの設備投資回復を背景に、当期の売上高は当社業績予想を上回る1兆1,272億円(前期比11.8%減少)となりました。セグメント別では、半導体製造装置の売上高は、1兆609億円(前期比9.1%減)、FPD製造装置の売上高は、660億円(前期比40.6%減)となりました。セグメント別の詳細については、7ページに記載されているセグメント別営業概況および事業展望をご参照ください。なお、フィールドソリューション事業(パーツ・中古装置販売、改造・保守サービス等)の売上高は、前期比5.7%増加の3,048億円となり、売上高全体の27.0%を占めました。

売上総利益および営業利益

売上総利益は、売上減少に伴い前期比14.1%減少の4,519億円となりました。売上総利益率については、売上高の減少に伴う製造経費比率上昇の影響を受け、前期比1.1ポイント低下の40.1%となりました。営業利益率についても、21.0%と前期比3.3ポイントの低下となりました。これは主に、顧客の投資が調整局面にある状況においても、当社の将来における成長機会を最大限取り込むため、研究開発等への成長投資を積極的に継続したことで、研究開発費等の対売上比率が上昇したことによるものです。

研究開発費

前期に引き続き、市場シェア向上に取り組んでいるエッチング・成膜・洗浄装置の研究開発を強化したことで、研究開発費の総額は前期から62億円増加、過去最高の1,202億円となり、売上高に対する比率は前期から1.8ポイント上昇し10.7%となりました。また、市場を創出するために、新しい分野の装置やプロセスの開発をCoporate Innovation本部で取り組んでおります。さらに、お客さまにより良いサービスを提供できるようIoTやAIを利用したアプリケーション開発にも積極的に取り組んでいます。

FPD製造装置分野では、加工均一性に優れたPICP™エッチング装置の展開が順調に進捗しましたが、今後のさらなる高解像度への要求に向けて、次世代PICP™の開発にも取り組んでいます。また、大型テレビだけでなく、ゲーミングで求められる高い解像度と反応速度の実現に向けて、インクジェット描画装置を利用した有機ELディスプレイの評価が進められています。

その他収益・費用および親会社株主に帰属する当期純利益

その他の収益・費用は、持分変動利益などを1億円の特別利益として、固定資産除却損などを5億円の特別損失として計上し、純額で3億円の費用となり、税金等調整前当期純利益は前期比23.9%減少の2,446億円となりました。その結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比25.4%減少の1,852億円、1株当たりの当期純利益は前期比22.7%減少の1,170.57円となりました。

包括利益

当期純利益の1,852億円に、政策保有株式に関連するその他有価証券評価差額金70億円、為替換算調整勘定△84億円、退職給付に係る調整額32億円などを計上したことにより、包括利益は1,870億円(前期は2,426億円)となりました。

配当政策および当期配当金

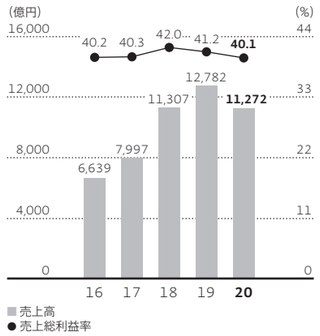
当社は、業績連動型の配当を株主還元の基本方針としており、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目途とする配当を実施しています。さらに安定配当の観点も考慮し、1株当たり通期150円という下限設定もおこなっています*。これにより、当期の年間配当金は、市場は調整局面ではありましたが、過去3番目に高い1株当たり588円(配当性向50.2%)となりました。今後もグローバルレベルの収益力の構築を目指すとともに、利益成長を通して株主の皆さまのご支援にお応えしていきます。

* 2期連続で当期利益を生まなかった場合は、下限設定の見直しを検討します。

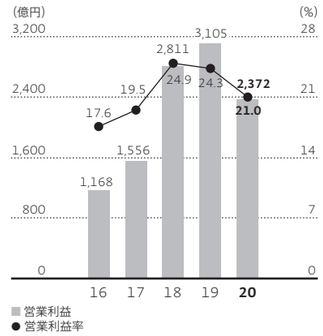
百万円

損益状況	2016	2017	2018	2019	2020
売上高	¥663,949	¥799,719	¥1,130,728	¥1,278,240	**¥1,127,286**
売上総利益	267,210	322,291	475,032	526,183	**451,941**
売上総利益率	40.2%	40.3%	42.0%	41.2%	**40.1%**
販売費及び一般管理費	150,421	166,594	193,860	215,612	**214,649**
営業利益	116,789	155,697	281,172	310,571	**237,292**
営業利益率	17.6%	19.5%	24.9%	24.3%	**21.0%**
税金等調整前当期純利益	106,467	149,116	275,242	321,508	**244,626**
親会社株主に帰属する当期純利益	77,892	115,208	204,371	248,228	**185,206**

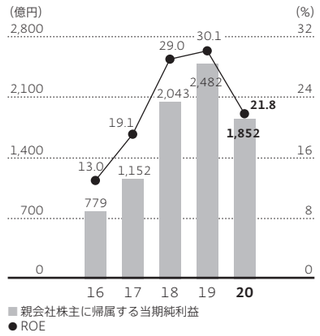
売上高および売上総利益率



営業利益および営業利益率



親会社株主に帰属する当期純利益およびROE



ROE=親会社株主に帰属する当期純利益/期首・期末平均自己資本×100

財務概況

▼ 財政状態およびキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

資産

流動資産は、前期末に比べ204億円減少し9,624億円となりました。これは主に、現金及び預金の減少277億円、有価証券に含まれる短期投資の減少265億円、たな卸資産の増加378億円によるものです。また、売上債権回転日数は49日（前期は42日）、たな卸資産回転日数は127日（前期は101日）となりました。

有形固定資産は、建設中の山梨・東北工場における新生産棟の建設仮勘定の増加、評価用機械装置の新規取得等で、純額で前期末から255億円増加し、1,755億円となりました。

投資その他の資産は、前期末から139億円増加し、1,295億円となりました。無形固定資産は、のれん償却や減価償却による減少、2022年3月期から順次導入予定の基幹システムによる増加などにより、前期末から18億円増加し、109億円となりました。これらの結果、総資産は、前期末から208億円増加し、1兆2,784億円となりました。

負債及び純資産

流動負債は、前期末に比べ776億円増加し、3,825億円となりました。これは主に、前受金の増加580億円、支払手形及び買掛金の増加204億円によるものです。

固定負債は、前期末に比べ15億円増加し、662億円となりました。

純資産は、前期末に比べ584億円減少し、8,296億円となりました。これは主に、自己株式の取得1,540億による減少、前期の期末配当及び当期の中間配当955億円の実施による減少、親会社株主に帰属する当期純利益1,852億円を計上したことによる増加によるものです。

この結果、自己資本比率は前期から5.9ポイント減少し64.1%となりました。なお、ROE（自己資本利益率）は、市場調整により親会社株主に帰属する当期純利益は減少しましたが、21.8%と高い収益性を維持できました。

設備投資[*1]および減価償却費[*2]

当期の設備投資額は、前期比9.9%増加し546億円となりました。主に、半導体製造装置事業における注力分野の強化に向けた研究開発用の機械装置や計測機器の取得に加え、成膜装置の需要増加に備えた東北・山梨工場の新生産棟の建設、関連子会社の耐震工事等をおこないました。

減価償却費は、前期比19.7%増加し291億円となりました。

[*1] 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。
[*2] 減価償却費にはのれん償却額および減損損失は含まれていません。

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べ153億円増加し、2,479億円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金および短期投資904億円を加えた残高は、前期末に比べ542億円減少し、3,384億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期に比べ635億円増加の2,531億円となりました。主な要因として、税金等調整前当期純利益2,446億円、前受金の増加586億円、減価償却費291億円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、たな卸資産の増加440億円、法人税等の支払額418億円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に短期投資の減少による収入800億円、有形固定資産の取得による支出493億円、定期預金の増加による支出104億円により、前期の840億円の支出に対し159億円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に自己株式の取得による支出1,540億円、配当金の支払955億円により、前期の1,297億円の支出に対し2,503億円の支出となりました。

百万円

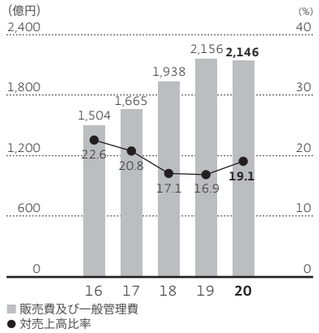
財政状態	2016	2017	2018	2019	2020
流動資産	¥617,416	¥775,938	¥ 946,597	¥ 982,897	¥ 962,484
有形固定資産	96,317	100,441	125,952	150,069	175,580
投資その他資産	79,635	81,067	130,246	124,661	140,431
総資産	793,368	957,447	1,202,796	1,257,627	1,278,495
流動負債	166,061	247,770	368,452	304,882	382,578
負債合計	229,129	311,447	431,287	369,510	448,802
純資産	564,239	645,999	771,509	888,117	829,692

（注）2019年3月期から「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）を適用しており、2018年3月期の「流動資産」、「投資その他資産」、「総資産」、「負債合計」は当該会計基準を遡って適用した後の数値を記載しています。

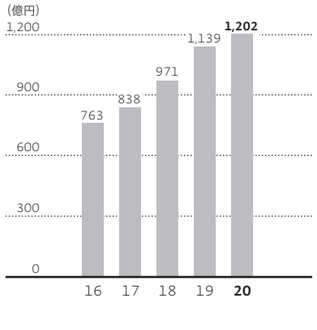
百万円

キャッシュ・フロー	2016	2017	2018	2019	2020
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥ 69,398	¥136,948	¥186,582	¥189,572	¥253,117
投資活動によるキャッシュ・フロー	(150,014)	(28,893)	(11,833)	(84,033)	15,951
財務活動によるキャッシュ・フロー	(138,601)	(39,380)	(82,549)	(129,761)	(250,374)
現金及び現金同等物期末残高	95,638	164,366	257,877	232,634	247,959

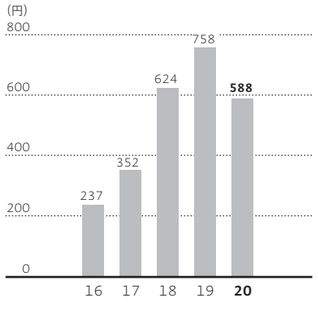
販売費及び一般管理費および対売上高比率



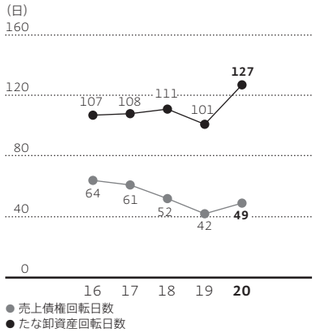
研究開発費



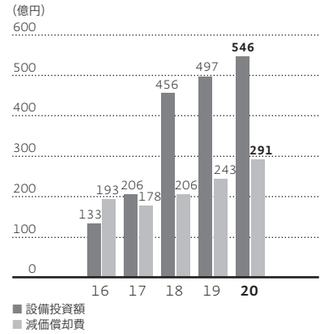
1株当たり配当金



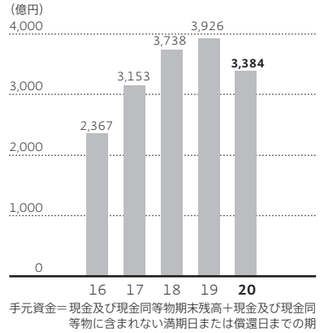
売上債権回転日数およびたな卸資産回転日数



設備投資額および減価償却費



手元資金



手元資金＝現金及び現金同等物期末残高＋現金及び現金同等物に含まれない満期日または償還日までの期間が3カ月を超える短期投資の残高

財務概況

▼ 事業等のリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1) 半導体市場変動

半導体市場は、世界経済の動向や最終製品の需要、貿易・関税政策、地政学的要因等の様々な影響を受け、その結果、需給バランスが崩れ短期的に大きく変動することがあります。半導体市場の予期せぬ急激な縮小が生じた場合には、受注取消、過剰生産能力の発生、不良在庫の増加、顧客の財務状況悪化による貸倒損失など、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。一方、想定を超える急激な需要の増加に対応できなかった場合には、顧客に製品をタイムリーに供給できず、売上の機会損失が生じるなど、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

中長期的には、IoT(Internet of Things)、次世代通信規格(5G)や人工知能(AI)等の普及により、技術革新が続き、半導体市場規模は拡大していくものと予想されております。しかしながら、短期的に発生しうる市場変動に対応するため、当社では、市場環境や受注状況を取締役会等の重要会議において定期的にレビューするなど、常に最新の市場動向を予測した上で、設備投資や人員・在庫等の適正化を図っております。また、当社は多様な半導体デバイスの半導体製造工程において幅広い製品ラインナップを有しており、それぞれが高いシェアを獲得し、各製品群が補完関係にあることで、市場変動への対応力を高めています。

(2) 特定顧客への取引集中

当社の売上高は、最先端の大手半導体メーカー向けが大きな割合を占めており、その主要顧客による投資動向の影響を受けやすい傾向にあります。主要顧客の設備投資が縮小した場合には、一時的に当該顧客への売上高が減少すること、また主要顧客の財務状況悪化により支払いが滞った場合には、売上債権が早期に回収できないこと等が考えられ、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

半導体市場規模は、中長期的には拡大していくものと予想されております。当社は、アカウントセールス本部を設置し、主要顧客と緊密な連携を図り、顧客の投資動向をいち早く把握することに努めるとともに、グローバルセールス本部を設置し、幅広い顧客ニーズに対応し、半導体需要の拡大に伴う新規顧客を開拓するなど、販売体制及び顧客基盤の強化と拡大に努めております。

(3) 研究開発

当社は、最先端技術について継続的な研究開発投資を実施し、当該技術を搭載した新製品を早期に市場投入することによって、各製品分野における高い市場シェアの獲得と高利益率の実現に成功してきました。しかしながら、顧客の技術要求に応える新製品をタイムリーに投入できない場合、また、開発した新製品が顧客要求に合致しなかった場合や競合他社による新技術・製品が先行投入された場合には、製品競争力を失い、開発コストを回収できず、高利益率の維持が困難となるなど、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社は、コーポレートイノベーション本部を設置し、革新的な技術開発と各開発本部が持つ製品・技術を融合した独創的な技術提案を行うための全社的な開発体制を構築するとともに、最先端顧客との間で、複数世代にわたる技術ロードマップを共有することで、将来のニーズに対応した強いネクストジェネレーションプロダクトを常に競合に先立ち提供する体制を整えております。

(4) 生産・供給

当社は、主要な生産拠点を日本国内に有し、国内外の顧客に製品を供給しております。そのため、国内において地震等の自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力による被害が生じ、生産が一時的に停止、復旧に時間を要する場合には、顧客に製品をタイムリーに供給できない可能性があります。また、円滑な製品製造にはサプライヤーによる安定供給が欠かせません。災害リスクに加え、サプライヤーの経営状態悪化等により、部品の調達が滞った場合にも、顧客に製品をタイムリーに供給できなくなり、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社は、事業継続計画(BCP)を策定し、定期的にそのレビューを行うとともに、代替生産体制の確立、重要部品のマルチソース化、生産棟の耐震強化、情報システムのバックアップ体制整備、適切な在庫コントロール等を通じ、製品の安定供給体制の確立に取り組んでおります。

(5) 安全

当社の製品に関連する安全性等の問題により、顧客への損害発生、受注取消等が発生した場合、損害賠償責任や売上高の減少、また、当社に対する信頼性の低下につながるなど、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理等の各業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動する「Safety First」という考えのもと、製品開発段階における安全設計の徹底、安全教育の推進や事故報告システムの整備など、製品の安全性向上や健康への影響排除のための取り組みを積極的かつ継続的に推進しております。

(6) 品質

当社の製品は、多くの最先端技術が統合・最適化された製品であり、予期せぬ不具合品が発生した場合は、リコール等の製造物・品質責任に基づく損害賠償責任や不具合対策費用の発生、売上高の減少、また、当社に対する信頼性の低下につながるなど、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社では、全社統一の品質方針のもと、社員及びサプライヤーに対して品質教育を推進し、ISO 9001の認証取得を含む品質保証体制や最高水準のサービス体制の確立に努め、製品の開発、設計の初期段階から顧客と連携することで、顧客の課題解決を図っております。また、不具合発生時においても根本原因を究明したのち再発防止・未然防止策の実施・徹底をすすめております。さらに、調達部品における品質向上の観点においても、サプライヤー品質を常に把握し、規程に基づきサプライヤーに向けた監査、改善支援等を実施しております。

(7) 法令・規制

当社は、グローバルに事業を展開する上で、各国・各地域において、輸出入、環境、競争法、労働、汚職・贈賄防止、移転価格税制を含む様々な分野の法令、規制による制約を受けており、その遵守に努めています。しかしながら、各種法令、規制に抵触した場合には、社会的信用の低下、課徴金・損害賠償の発生、事業の制限等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、将来において予期せぬ法令改正、規制の強化が生じた際に適切に対応できなかった場合には、その対応に要する費用負担や事業の制限等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーのもと、国内外主要拠点におけるコンプライアンスに関する活動状況を把握する体制を構築しております。また、コンプライアンスに関するアセスメントを実施し、抽出された課題は、CEO、取締役会及び監査役会に報告され、迅速かつ効果的な対策を実施できる体制を整備しております。

(8) 知的財産

当社の製品は、多くの最先端技術が統合・最適化された製品であり、当社の知的財産権の権利化と第三者による権利侵害の防止は、製品の差別化と競争力強化の上で重要な要素となります。また、第三者が保有する知的財産権を侵害した場合には、当社製品の生産・販売が制約され、損害賠償金の支払が発生すること等が考えられ、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社は、研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、適切な知的財産権ポートフォリオを構築し、多くの独自技術の専有化を図り、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保を実現しております。

(9) 情報セキュリティ

当社は、事業活動を通じて、機密情報、顧客情報、個人情報等を取得・保有し、これらを利用しております。こうした情報が意図せず流出した場合、社会的信用の低下や、損害賠償の発生、製品競争力の低下等により、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社は、情報システム及び情報ネットワークを駆使しながら事業活動を行っております。サイバー攻撃、不正アクセス、自然災害、停電、機器類の故障、人為的ミスなどにより障害等が発生した場合には、業務の停滞や信用の低下が生じることが考えられます。

当社では、情報管理に関する諸規程を制定し、適切な情報管理体制を構築していることに加え、情報システム・情報ネットワークのセキュリティ体制については、セキュリティ・アセスメントを実施するなど、セキュリティの安全性を確認し、さらなる体制強化を図っております。

(10) 人材確保

当社がグローバルな事業展開をすすめるなか、イノベーションを創出し成長を続けるためには、国内外で人材を確保し、育成することが重要となります。しかしながら、必要な人材を継続的に採用・維持することができない場合や重要人材を喪失した場合には、人材不足による製品開発力の低下や顧客サポートの質の低下を招き、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社は、社員は持続的な価値創造の源泉であり、社員のエンゲージメントを高めることは企業価値向上において最も重要な要素と考えております。具体的にはグローバル共通の人事制度や中期業績に連動したインセンティブプランの導入、長時間労働・ハラスメントの防止を含めた労働環境の継続的な改善や健康経営の推進等に取り組んでおります。

(11) 環境対応

当社を取り巻くステークホルダーからの環境負荷低減に関する要請が高まっております。こうしたなか、環境法令や業界行動規範、顧客ニーズ等に適切に対応できなかった場合には、対応費用の発生や製品競争力の低下、社会的信用の低下等により、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社は、環境法令や業界行動規範を遵守することに加え、中長期環境目標を自ら定め、製品使用時の温室効果ガス排出量削減や事業所におけるエネルギー使用量低減に努めております。そのほか、半導体の低消費電力化に寄与する技術の提供や中古装置・中古パーツビジネスの推進、装置サイズの縮小やスループット改善による生産性の向上等、事業活動を通じて地球の環境保全に取り組んでおります。

(12) 新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症の拡大は、当社の製造・販売活動等の事業継続に影響を与える可能性があることに加え、世界的にヒトやモノの移動が制限され、世界経済の状況が悪化するなど、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社においては、CEOを本部長とする緊急対策本部を設置し、感染リスクの高い国や地域への渡航制限、サプライチェーンの維持、事業所における感染予防策の徹底等の対策を講じております。

(13) その他

当社が事業を遂行するにあたっては、世界及び各地域における経済環境、金融・株式市場、商品・不動産市況、外国為替変動、企業買収の成否、重要な訴訟、標準規格化競争等の影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されますが、それぞれのリスクに対し適切な対策を講じております。